

2014 年 10 月 29 日

大幅な小型化を実現した省スペース内面研削盤「SG2-C/R」を発売

セイコーインスツル株式会社(略称:SII、社長:村上 斉、本社:千葉県千葉市)は、内面研削盤の新製品「SG2-C/R」の販売を開始いたしました。

チャックタイプ機としては従来比 60%(設置面積)と大幅な小型化を実現し、様々な加工バリエーションに対応した省スペース内面研削盤です。高精度のダイヤフラムチャック主軸を搭載し、自動車部品やベアリングなど、小径かつ高精度が求められる部品加工に最適です。



SIIは、時計製造で培った精密加工技術で、小型・高速・高精度な内面研削盤を製造・販売しています。なお、2014 年 10 月 30 日(木)～11 月 4 日(火)に東京ビックサイトで開催される「JIMTOF2014 第 27 回日本国際工作機械見本市」に出展いたします。

【主な特長】

1. 大幅な小型化を実現

本体寸法、850mm(W) × 1,162mm(D) × 1,580mm(H)と、従来の当社製チャックタイプの機械に比べて約 60%(設置面積)と大幅な小型化を実現しました。機械据付面積が小さく、工場スペースの有効活用が図れます。

2. 高速・高精度な加工を実現

新たに高精度なダイヤフラムチャック主軸を搭載できます。チャック主軸には、サーボモータ駆動の 2 アームローダを搭載し、加工物の高速自給を可能にしました。砥石軸スピンドルは 80,000 回転～180,000 回転(min⁻¹)まで搭載可能で、高精度な加工を実現できます。

3. 加工物に合わせたオプション

オプションで、フロント定寸装置、AEセンサー内蔵のドレス装置などを、加工物に合わせて搭載可能です。

【加工仕様】

(mm)	Cタイプ (チャック主軸)	Rタイプ (2 ロール 1 シュー主軸)
加工物 外径	φ 8～φ 20	φ 1.5～φ 16
加工物 内径	φ 3～φ 12	φ 1.0～φ 10
加工物 幅	2.5～20	1～8

【製品概要】

本体寸法	850mm(W) × 1,162mm(D) × 1,580mm(H)
機械重量	1,700Kg (※オプションにより異なります)

以 上

【本件に関するお問い合わせ】

〔報道関係〕

セイコーインスツル株式会社
経営管理部 広報課 荒井、森
TEL: 043-211-1185 MAIL: pr@sii.co.jp

〔一般のお客様〕(紙面などの掲載時はこちらでお願いします)

セイコーインスツル株式会社
精機事業部
TEL: 047-392-2091 MAIL: naiken@sii.co.jp